

SW201

硅片切割液

产品介绍

SW201 是一款全成型水溶性(水基)硅片切割液, 以新型聚醚类润滑剂为主, 具有比合成酯、聚酯、太古油、油酸三乙醇胺皂等传统的油性剂更佳的润滑效果。它主要用于半导体行业的切割工艺, 具有优异的润滑、冷却、防腐、防锈、氢气抑制功能, 切割后的硅片表面 TTV 小, 无线痕, 并且能够延长金刚砂线的使用寿命。

产品特点

- 具有优异的润滑、冷却、防腐、防锈、氢气抑制功能
- 含有独特的化学清洗添加剂, 使得切割后的硅晶片十分干净, 便于切割后清洗;
- 切割后的硅片表面 TTV 小, 无线痕;
- 能够延长金刚砂线的使用寿命。

典型数据

pH 值(20°C)	6-8
沸点	≥100°C
闪点	无闪点
冰点	<0°C
比重 (20°C)	1.01-1.06
外观	无色透明液体

包装

25 升桶装

订货号

SW201_25L

产品使用:

- 1、配制方法：在充分搅拌下将本品徐徐加入稀释水中，加完后再搅拌、循环 3~5 分钟。充分搅拌可得到均匀、稳定的工作液。配制比例 0.3-1%；
- 2、使用注意：事先清除前工序附着在工件上的化学物质；即时去除切屑、粉末和浮油；避免异种切削液混溶。